Japanese Patent Application Publication (JP-B) No.54-25957

Publication Date: August 31, 1979

Application No.: 51-9947

Application Date: January 31, 1976

TITLE: POLYMERS FOR AQUEOUS PROCESSED PHOTORESISTS

Applicant: Dynachem Corporation, Santa Ana, Calif.

Abstract:

A new photopolymerizable composition which contains an addition polymerizable monomer, a photoinitiator, and an improved binding agent which is a polymer of three types of monomeric materials, namely, a styrene-type monomer, an acrylate monomer, and an alpha, beta-unsaturated carboxyl-containing monomer. These compositions are useful for flexible photopolymerizable films which, after exposure, may be developed in aqueous alkaline solutions. These films may be used as photo-resists, screen stencils and printing plates.

⑫ 特 許 公 報 (B2)

昭54-25957

5 Int.Cl.2	識別記号	 日本分類	庁内整理番号	20 49公告 昭和54年(1979) 8月31日
C 08 F 2/50 C 08 F 2/44// G 03 C 1/68 G 03 F 7/10 H 05 K 3/06		26(3) B 0 26(3) A 22 26(3) A 103 116 A 415 103 B 0 59 G 416	6358-4 J 6791-2 H 7267-2 H 7638-5 F	発明の数 1 (全 12 頁)
	-	39 G 410		

1

2

匈光重合性組成物およびその製法

題 昭51-9947 创特

纽出 願 昭51(1976)1月31日

公 開 昭52-94388

@昭52(1977)8月8日

明 者 メルヴイン・エイ・リプソン 個発

> アメリカ合衆国カリフオルニア州 92632フアラートン・アルテ

イヴォ・プレース2829

ユージン・ザドーア 同

> アメリカ合衆国カリフオルニア州 92633フアラートン・ミラダ

1609エイ・ヴイア

の出 顔 人 ダイナケム・コーポレーション 15 アメリカ合衆国カリフオルニア州

> 92680タステイン・ミツシエ ル・ドライプ2632

個代 理 人 弁理士 中村稔 外1名

釣特許請求の範囲

1 (A) 100℃より高い沸点を有する1または それ以上の非ガス状化合物より本質的に成る附 加重合物質

(B) 光により開始される遊離基発生附加重合開始 25 2 予備成形された高分子重合結合剤が 系;および

(C) 一般式

 $R-C=CH_{2}$

を有する群から選ばれた1またはそれ以上のス チレン型化合物またはその環置換誘導体を含有 する第1重合性物質 40~60%;

アルキル基が1~6個の炭素原子を有し、ヒ ドロキシアルキル基が2~6個の炭素原子を有 するアルキルアクリレート、アルキルメタクリ レート、ヒドロキシアルキルアクリレート、ま たはヒドロキシアクリルアクリレートより成る 群から選ばれる1またはそれ以上の化合物を含 10 有する第2重合性物質 15~45%;

3~15個の炭素原子を有する1またはそれ 以上のα・βー不飽和カルポキシル基含有モノ マーを含有する第3重合性物質

15~40%;

の重合体であつて、40%溶液になる様にメ チルエチルケトンに溶解した場合に、プルツク フイールド粘度計で少くとも2000センチポ イズの粘度を有する予備成形された高分子重合 40~90重量部 結合剤

20 より成り、pH 9乃至14のアルカリ水溶液に可 溶であり、1ミル厚のフイルムにおいて10~ 2.0 のスワード便度、2ミル厚のフイルムにおい て8~14のスワード硬度を有することを特徴と 10~60重量部: する光重合性組成物。

40~60% スチレン;

15~45% メチルメタアクリレートとエ チルアクリレートより成るア

クリレート成分;

15~40% メタクリル酸

の共重合体である特許請求の範囲第1項に記載 の共重合性組成物。

(但し、式中、

Rは水素、1~6個の炭素原子を有するアル 35 3 予備成形された高分子重合結合剤のメチルエ チルケトン中40%溶液が2500~8000セ キル基またはハロ基を示す)

30

ンチポイズの粘度を有する特許請求の範囲第1項 に記載の組成物。

4 予備成形された重合結合剤が、 45~55%の第1単量体物質; 25~35%の第2単量体物質;および 18~30%の第3単量体物質

の重合体である特許請求の範囲第1項に記載の組 成物。

発明の詳細な説明

用法に関し、更に詳しくは、アルカリ水溶液によ つて現像でき、しかもその水溶液から可撓性フィ ルムを生ずる感光性組成物に関する。

かかる感光性組成物から形成されるフォトレジ ストは、通常に使用されているメツキ液やエツチ 15 ムになつてしまう。 ング液に対して耐性があるから、プリント回路用 フオトレジストとして用いられ、またスクリーン ステンシルや印刷板の成形材料としても有用であ

かつ可燃性でもある。その上、空気や水を汚染す るという欠点をも有している。そのためかかる有 機容媒を使用しないで現像できる感光性組成物を 得ることが長い間熱望されて来た。かかる有機溶 媒を使用しないで、アルカリ水溶液で現像される 25 マー、(2)アクリレート型モノマー、および(3)不飽 系が英国特許第1361298号に記載されてい る。この英国特許第1361298号に記載され ている組成物は企図された目的には非常に有用で あるが、それを乾燥したフイルム積層体として用 いたと きに極めて可撓性に欠けるという欠点を有 30 に可撓性と可塑性とを付与し、第 3 の成分はアル している。脆いフイルムは使用中または使用前に クラツクを生ずるばかりでなく、使用者がマスタ ーロールを所望のサイズに切断する時に適度にス リットし損うという欠点を有する。また、スリッ トロールの端にはスライバーが形成され、光重合 35 と(3)1~10重量部の通常のフリーラジカル光重 性組成物層を、基体であるポリエステル層から分 離させる欠点をもつ。この現象の起る領域では光 重合性組成物層に適度の感光が起らず、現像後の レジストとしての機能を失う。このように脆いフ イルムは、たとえそれが回路板として使用されて 40 化学的性質を向上させるのに役立つ。例えば可塑 も回路板を折り曲げた時にクラックが起きたり、 またフイルムが回路板から剝離したりするため可 **撓性の回路設計には役立たない。**

従来公知の手段として可撓性を改良するため外

部可塑剤を混入する例がある。しかしながらこの 方法によつては可塑剤が時間と共にミグレイショ ンを起こしたり、ひどいコールドフローを起こし たりして必ずしも満足のゆくものでなかつた。特 5 にコールドフローは、フイルムのロールが静的負 荷の状態に置かれるため短時間で、光重合性物質 を層間からにじみ出し始めるから、耐え難い欠点 となつている。このにじみ出た物質がロールの端 で融け、不可能といわぬまでも均一にしかも対向 本発明は、新規な光重合性組成物およびその使 10 するフイルムを損うことなくロールからほぐすこ とを困難にするということである。また、前記外 部可塑剤を含む組成物からフイルムを製造するに 当つては、乾燥を正確にコントロールしないと、 可塑剤が蒸発してしまいもとの脆い状態のフイル

本発明は、乾燥フイルムであつても外部可塑剤 なしで良好な可撓性を示すと同時に高い耐コール ドフロー性を有する水で現像される光重合性組成 物を発見したことにある。その上、この組成物を 有機溶媒は一般にコストが高く、毒性があり、 20 露光して重合体に変性した個所は、プリント回路 や化学的機械部品の製造に当つて使用される典型 的な溶液ーアルカリ性エッチング剤やアルカリ性 メツキ液等ーに対して著しい耐性を示す。

> 要するに、本発明の利点は、(1)スチレン型モノ 和カルポキシル基含有モノマーからなる共重合体 を適合する巨大分子の髙分子結合剤として選定し たことにある。第1の成分は、重合体に固さと耐 化学薬品性を付与し、第2の成分は重合体の骨格 カリ可溶性を付与する。

> 本発明の光重合性組成物は、(1)10~60重量 部の通常の附加重合性で非ガス状のエチレン性不 飽和化合物と、(2)40~90重量部の前記結合剤 合開始剤とから構成される。通常の熱附加重合禁 止剤も、5重量部まで、好ましくは0.005~ 2.0 重量部まで加えてよい。 さらに前記組成物に は、染料や質料、その他光重合性組成物の物理的 剤、接着促進剤等の添加物を添加してもよい。

エチレン性不飽和化合物は、少なくとも1つの

末端エチレン基(CH2=C <</br>

気圧下で100℃以上の沸点を有し、その上フリ ーラジカル光重合的開始剤による連鎖重合反応で 高分子量の重合体を形成するものでなければなら ない。このような化合物は、米国特許第 2760863号に開示されている。

この化合物としては、常温で液体または固体で あつて1~4またはそれ以上の、好ましくは2個 またはそれより多くの末端エチレン基を有し、か つ熱可塑性重合性結合剤に可塑剤的作用を有する 原子数2~15のアルキレングリコールまたは1 ~10のエーテル結合を有するポリアルキレンエ ーテルグリコールから合成されたアルキレンまた はポリアルキレングリコールジアクリレートが巻 げられる。これらは単独ではまた混合物としても 15 ホネート等のピニルエステル;ソルプアルデヒド 使用できる。゛

露光によつて不容性になる速さ、これは多分、 高分子の急速な網目構造になることに因ると考え られるが、低分子量の付加重合性成分のうち、付 加重合性エチレン結合を有する成分、特にこのエ 20 体によつて変えられる。 チレン結合が末端にある化合物、少なくとも前記 結合の1つが二重結合性の炭素、即ち炭素炭素二 重結合、窒素、酸素、イオウ等のヘテロ原子と二 重結合を形成するような炭素と共役して存在する 残基を有する成分が最も優れている。これらの化 25 合物として、エチレン性不飽和基とくにピニリデ ン基がエステルまたはアミド構造と共役している ものがよい。次に、特定する化合物はこれらの群 の化合物をさらに説明するためのものである。ポ リオールの不飽和エステル、特にメチレンカルポ 30 ある。ペンゼン環は、ニトロ基、アルコキシ基、 ン酸のエステル、例えば、エチレンジアクリレー ト;ジェチレングリコールジアクリレート;テト ラエチレングリコールジアクリレート; グリセリ ンジアクリレート;トリメチロールプロパントリ アクリレート:グリセリントリアクリレート;エ 35 t-プチル基等の単一のアルキル基である。上述 チレンジメタクリレート;1・3ープロピレンジ メタクリレート;1・2・4 ープタントリオール トリメタクリレート;1・4 ーペンゼンージオー ルジメタクリレート;ペンタエリトリトールテト ラメタクリレート;1・3 -プロパンジオールジ 40 好ましくは1~6 のアルキル基を有するアルキル アクリレート;1・5ーペンタンジオールジメタ ル)フエニルー2・2ープロパン等のポリエチレ

ングリコールとエトキシル化アルコールとフエノ

ールとからなるピスーアクリレートまたはピスメ タクリレート;不飽和アミド、特にメチレンカル ポン酸や、メチレンピスアクリルアミド;メチレ ンピスーメタクリルーアミド;1・6ーヘキサメ 5 チレンピスーアクリルアミド;ジェチレントリア ミントリスーメタクリルアミド;ピス(メタクリ ルアミドプロポキシ)エタン;βーメタクリルア ミドエチルメタクリレート; N-((β-ヒドロ キシーエチルオキシ)エチル)アクリルアミド等 ものが望ましい。好ましい化合物としては、炭素 10 のlpha \cdot Ω - arphiアミンおよび酸素原子介在の Ω - arphiアミン類のアミド;ジピニルサクシネート、ジビ ニルアジペート、ジピニルフタレート、ジピニル テレフタレート、 ジビニルペンゼンー1・3ージ スルホネート、ジピニルプタン-1・4ージスル (ヘキサジエナール)等の不飽和アルデヒド。

> 好ましい単量体は二官能性または多官能性の単 量体であるが、単官能性の単層体も使用できる。 加えるべき単量体の量は、特定する熱可塑性重合

重合性結合剤のスチレン型成分は、一般式

$$R-C = CH_2$$

(式中、Rは水素、炭素原子数1~6のアルキル 基またはハロゲンである)で表わされる化合物で アシル基、カルポキシル基、スルホ基、ヒドロキ シ基またはハロゲン等の官能基で置換されてもよ い。ペンゼン核の置換残基は1~5の範囲であつ てよい。好ましい置換基としては、メチルまたは の化合物のうち最も好ましい化合物は、 スチレン αーメチルスチレン、パラメチルスチレンおよび パラtープチルスチレンである。

アクリレート型成分は、炭素原子数1~12. ヒドロキシアルキルアクリレート、またはアルキ ル、ヒドロキシアルキルメタクリレードである。 これらの化合物の例として、メチルメタクリレー ト、エチルアクリレート、ヒドロキシプロピルメ

タクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート およびヒトロキシエチルアクリレートがある。ま たこれらの化合物 2種またはそれ以上のものの混 合物も用いられる。

好ましくは3~6の不飽和カルポキシル基含有単 量体の1またはそれ以上が挙げられる。最も好ま しい化合物としては、アクリル酸およびメタクリ ル酸がある。使用し得る他の酸としては、ケイ皮 酸、クロトン酸、ソルビン酸、イタコン酸、プロ 10 化学的、物理的特性を害することはない。 ピオール酸、マレイン酸およびフマル酸がある。 またこれらの半エステル類または無水物も可能で ある。結合剤中の3成分の割合は、その結合剤を 混入する光重合性組成物が次の各性質をもつよう に選択されねばならない。即ち、第1に、光重合 15 起る。他方、可撓性のフイルムであれば、連続し 性組成物は、可撓性があり、かつ固くなければな らない。ただし粘着性があつてはならない。第2 に、未露光光重合性物質は、 pH 9~14のアル カリ水溶液中で現像されなければならない;第3 に光重合性物質は、穏和なアルカリ水溶液ないし 20 剰乾燥した試料は、上述の試験法に供される。薄 はエッチング剤 (pH 約 8.5 のピロリン酸銅メッ キ俗)に対して耐性がなければならない;第4に、 結合剤の40%メチルエチルケトン溶液の粘度は、 少なくとも2000センチポイズでなければなら ない。この粘度の好ましい範囲は、2500~ 25 合性フイルムを少なくとも152メートル 8000センチポイズである。粘度の測定は、い ずれもプルツクフィールドの粘度計による。

結合剤を合成するのに使用される単量体の3成 分の重量割合を次表に示す。

		•
結合剤成分	広い範囲	好適範囲
スチレン型	40~60%	45~55%
アクリレート基	15~45%	25~35%
カルポン酸基	15~40%	18~30%3

乾燥フイルムを実験室的に製造するに当つての 塗布および乾燥法として次のものがある。即ち、 メチルエチルケトン溶液にすべての成分を混入し ン溶液で希釈して、粘度を100~200センチ ポイズにする。この塗液を、強化ガラス上に拡げ た長さ10フィート、幅5センチのポリエステル 膜上に塗布する。均一な薄い塗膜は、メイヤーロ

ッドないしはガードナードクターナイフを用いて 形成する。厚さは、乾燥後1ないし2ミルの厚さ のフイルムになるように調整する。

乾燥は、例えば150ワットのドライヤーを用 第3共単量体としては、炭素原子数3~15、 5 いて行なう。ドライヤーは、全乾燥を行い得る実 験室規膜のトンネルの一方の端に置かれる。熱風 を20分間継続的に送風し、残存溶媒の量が約 0.1~2%になるまでフイルムを乾燥する。この 程度の残存密媒量では、乾燥フイルムレジストの

> 乾燥フイルムの可撓性は、そのフイルムをしわ くちやに丸め、次いで引き伸ばすことによつて測 る。こうした数多くの折りたたみを積み重ねると 脆いフイルムであれば、クラツクないしは剝離が たシートの状態で残る。

可撓性と乾燥の寛容度とは、試料フイルムを強 制対流炉中で82℃(180平)、10分間過剰 乾燥する試験法によつても調べられる。勿論、過 い1、2ミル程度の非支持光重合体フィルムのコ ールドフロー性についての工業的測定法は、フィ ルム自体の性癖もあつて確定したものは認められ ていない。最もよい方法は、現実に2ミルの光重

(500フイート)、通常の張力下で芯に擦き、 そのフイルムを相当の期間室温下で端で立てて置 くことである。良好なフイルムであれば、6ヶ月 間18°~24℃(65°~75F)であつても 30 端に溶融の現象が起らない。

前述の経験的なコールドフロー測定法と密接な 関係を有する2つの定性的な測定法がある。その 1つはスウオード硬度法であり、他の1つは"真 空下のコールドフロー "法 (cold -flow-35 under — vacuum)である。

スウオード硬度指数は、試料フイルムの表面硬 度と標準ガラスの表面硬度の比で表わされる。ス ウオードロツカーは最初ガラスに対する銃み 100を目盛り、次いで同一ガラスシート上に積 攪拌して塗布溶液を作る。この溶液をさらにケト 40 層した試料フイルムの読みを計る。良好な1ミル の水で現像できるフイルムのスウオード便度は 10~20であり、また2ミルフイルムのそれは 8~14である。

静的負荷としての真空下コールドフロー法にお

いては、試料フイルムを銅に積属し、次いでポリ エステル基体を適当な位置に置いて、細いワイヤ (直径12~13ミル)を頂部に置く。全系を5 分間675cmHg の真空下に放置する。処理後ボ リエステル基体を注意架く取り除き、ワイヤの目 5 ーピスジアルキルアミノーペンゾフエノン、特に 盛をフイルムの端からの『にじみ出し』と同じく 写真にとる。このフイルムの写真と既知のコール ドフロー特性を有するフイルムとを比較検討する。

前に述べたように本発明の組成物からなるレジ ストは、通常のメツキ液およびエツチング液に耐 10 ではあるが、光重合性組成物には必ずしも不可欠 性がある。もつとも驚くべきことはピロリン酸銅 溶液に対する耐性である。ピロリン酸銅はメッキ に使用され、きわめて高いアルカリ度を有する。 レジストに影響しない他の溶液としては、塩化第 二鉄、過硫酸アンモニウムおよび硫酸クロム溶液 15 ル樹脂酸銅、ナフチルアミン、βーナフトール、 がある。

本発明の組成物で使用される光重合開始剤は、 化学線で活性化でき、185℃またはそれ以下の 温度では熱的に活性化しない物質が推奨される。 これらの物質としては、次に挙げるような置換ま 20 pートルキノン、クロラニル、アリールフォスフ たは非置換の多核キノンがある。9・10-アン トラキノン;1-クロロアントラキノン、2-ク ロロアントラキノン、2ーメチルーアントラキノ ン; 2-エチルアントラキノン; 2-tert ープ チルーアントラキノン;オクタメチルアントラキ 25 立でき、感光性に少しの影響をも与えないもので ノン;1・4ーナフタキノン;9・10ーフエナ ントラキノン;1・2ーペンズアントラキノン; 2・3ーペンズアントラキノン;2ーメチルー1・ 4ーナフタキノン;2・3ージクロロナフタキノ ン;1・4 ージメチルアントラキノン;2・3 ー 30 シドグリーンS(C.I.4 4 0 9 0);パラマジ ジメチルアントラキノン;2ーフエニルアントラ キノン; 2・3ージフエニルアントラキノン;ア ントラキノンαースルホン酸のナトリウム塩;3 ークロロー2ーメチルアントラキノン;レテンキ ノン;7・8 ・9・1 0 ーテトラヒドロナフタセ 35 (C.I. 4 2 6 9 0);ナイルブルー 2 B(C. ンキノン;1・2・3・4ーテトラヒドロペンズ (a) アントラセンー7・12 -ジオン。

また、光重合的開始剤として有用なものとして ジアセチルおよびペンジル等の vic ーケタルドニ ル化合物:ペンゾイン、ピパロイン等のαーケタ 40 I. 42115); C.I.ダイレクトイエロー9 ルドニルアルコールおよびエーテル;ペンゾイン メチルおよびエチルエーテル、並びに*α* –炭化水 素置換芳香族アシロイン、例えばα −メチルペン ゾイン、 αーアルリルペンゾインおよび αーフェ

ニルーペンゾイン;およびα・αージアルコキシ アシルフエノン、例えばα・αージエトキシアセ トフエノンがある。有効な重合開始削としては芳 香族ケトン、例えばペンソフエノンおよび4・4′ Michlerケトンと呼ばれるジメチルアミノ化合物 がある。

一般的に、乾燥、貯蔵の間に熱重合反応を起さ せない禁止剤を混入せしめることは好ましいこと のものではない。かかる熱重合禁止剤としては、 Pーメトキシフエノール、ヒドロキノン、および アルキルまたはアリール置換ヒドロキノンまたは キノン、tert ープチルカテコール、ピロガロー 塩化第1銅、2・6 ージー tert ープチル p ーク レゾール、2・2ーメチレンピス(4ーエチルー 6-t-プチルフエノール)、フエノチアジン、 ピリジン、ニトロペンゼン、ジニトロペンゼン、 アイト、およびアリールアルキルホスフアイトが ある。

所望ならば、前記組成物は染料や顔科を含有し てもよい。最適な着色剤は、光重合性組成物と両 ある。

次に列挙する化合物は、かかる着色剤を説明す るものである; フクシン(C.I.42510); オーラミン塩基(C.I.41000B);カルコ エンタ(C.I.42500);トリパロサン(C. I. 42505); = 2 - 792298 (C.I.4 2 5 2 0) ; アシッドパイオレット R R H (C. I. 42425);レッドパイオレット5RS I. 51185);ニユーメチレンプルーGG (C.I.51195); C.I.ペイシックプルー 20(C.I.42585); アイオジングリーン $(C.I.42556); +1+//1-\nu B(C.$ (C.I.19540); C.I.アシッドイエロー 17 (C.I.18965); C.I.アシッドイエ ロー29(C.I.18900);タートラジン (C.I.19140);サプラミンイエローG

(C.I.19300); パフアロープラック 10B(C.I.27790);ナフタレンプラツ ク12R(C.I.20350);フアーストプラ ツクL(C.I.51215);エチルパイオレツ -BL(C.I.50305);ポンタシルウール プルーGL(C.I.52320);(カラーイン デックス第 2版による)。

光重合可能な要素は、化学的に活性な放射線に 露光される。この露光は、ハーフトーン像または 10 ミノー2ーヒドロキシメチルー1・3ープロパン プロセス透明度、例えばプロセス陰画または陽画 ステンシルないしはマスクを通して行なわれる。 露光はまた連続トーンの陰画または陽画を通して 行なつてもよい。 露光は、光重合性層にカパーシ で行なつてもよいし、カバーシートを用いる投影 でもよい。これらの方法は、当業界の専門家には 明白なものである。

フリーラジカルを発生する付加重合開始剤は、 化学的放射線(活性放射線)で活性化されるが、 20 えばトリメチルー、ジエチルメチルー、ジメチル その感受性は、紫外線領域において最大である。 その故に放射線源は、この紫外線を有効に放射す るものにすべきである。点または広域放射線原が 有効である。こうした放射線源としては、カーボ ンアーク、水銀蒸気アーク、紫外線放射性螢光体 25 ム、ピロリン酸ナトリウムまたはピロリン酸カリ を設えた螢光灯、アルゴングローランプ、電子セ ン光体および写真用フラッド電球がある。これら のなかでもとりわけ水銀蒸気アーク、太陽ランプ が好適である。ある場合には可視光線に露光して もよい。この場合には可視光線に感受性のある光 30 開始剤を用いる必要がある。この光開始剤として は例えば9・10-フエナンスレンキノンがある。 勿論、可視光線を有効に放射する線源を用いるこ とはいうまでもない。上述の放射線源の多くは、 かかる可視光線の必要量を供給する。

露光後、光重合性組成物は、例えばスプレージ エツトの衝突により、攪拌付の浸漬により、また はプラツシング、スクラッピング等により現像さ れる。この現像法のうちプラツシングとスクラツ ピング法では、濃度 0.01~10 重量%のアルカ 40 のポリエチレンフイルムで覆つた。 リ水溶液を用いて所望の像に現像が行なわれる。 現像用の塩基としては、水酸化アルカリ金属、 即ちリチウム、ナトリウムおよびカリウムの水酸

化物:弱酸の塩基反応アルカリ金属塩即ちリチウ ム、ナトリウムおよびカリウムの炭酸塩または重 炭酸塩;塩基性度約1×10 ° 以上のアミン即 **ちペンジル、プチルおよびアリルアミン等の第1** ト(C.I.42600);ポンタシルウールプル 5 アミン;第2アミン例えばジメチルアミン、ペン ジルメチルアミン;第3アミン例えばトリメチル アミン、トリエチルアミン;第1、第2、第3の ヒドロキシルアミン例えばプロパノール、ジエタ ノール、トリエタノールの各アミンおよび2ーア シオール:環式アミン例えばモルホリン、ピペラ ジン、ピペリジン、ピリジン;ポリアミン例えば ヒドラジン、エチレンおよびヘキサメチレンアミ ン;水可溶性塩基性塩例えば上記各アミンの炭酸 ートを設けまたは設けずに接触法ないしは投影法 15 塩ないしは重炭酸塩;アンモニウムヒドロキシド およびテトラ置換アンモニウムヒドロキシド例え ばテトラメチルー、テトラエチルー、トリメチル ベンジルー、およびトリメチルフエニルアンモニ ウムヒドロキシド、スルホニウムヒドロキシド例 ベンジルスルホニウムヒドロキシド、およびこれ らの可溶性塩基性塩例えば炭酸塩、重炭酸塩およ び硫化物;アルカリ金属リン酸塩およびピロリン 酸塩例えばリン酸カリウムまたはリン酸ナトリウ ウム;テトラー置換(好ましくは全アルキル)ホ スホニウム、アルソニウムおよびスチポニウムヒ ドロキシド例えばテトラメチルホスホニウムヒド ロキシドがある。

> - 光重合した組成物は、もし所望なら、公知の独 占的ストリッピング処方である強アルカリの加熱 水溶液に浸漬することにより容易に除去できる。

> 本発明は、次の各実施例によつて更に詳しく説 明される。

35 実施例 1

次の溶液を1ミル厚さのポリエステルフイルム 上に塗布し、GE-1500ワットのドライヤー の熱風流で 20 分間乾燥した。感受性層の乾燥後 の厚さは約1ミルであつた。乾燥層を1ミル厚さ

榕液Aは、本発明の組成を示し、溶液Bは比較 例を示す。

容液A

			14
(a) 50%スチレン、20%メチ ルメタクリレート、10%エチ ルアクリレート、20%メタク			(k) メチルエチルケトン 2 1 0.0 8
リル酸からなる共重合体;粘度	4 0.0 %	6	銅破優エポキシガラスフアイバー板をクレンザ
(40%のメチルエチルケトン 溶液で側定)4500 cps 25			ーでとすつて洗い、拭いた後、水で完全にすすぐ。
C		5	次いで、20秒間、12%の塩酸水溶液に浸漉し
(b) エトキシル化ピスフエノール			水ですすぎ、空気流で乾燥する。
Aジアクリレート *	1 4.0 9	7	ポリエチレンカパーシートを除去し、奇麗な銅
/3 = 1 = 1/1/ William 11/2			面と光重合性層が接するように、ポリエステル支
(c) テトラエチレングリコールジ アクリレート	7.0 8	7	持体を有する裸のレジスト被覆を積層する。接合
(A) 201877714	0.056	. 10)に当つては、ゴム被覆ローラを用い、速度2フイ
(d) ペンゾフエノン	2.257	_	ート/分、121℃(250F)、接点での圧力
(e) 4 · 4′ ーピス ー (ジメチルア	0.308	7	$42.6 \text{kg/cm} \left(3 \text{ポンド/in}^2\right)$ で行なつた。ポ
ミノ) ペンソフエノン			リエステルフイルムで覆われた銅破覆ポートを、
(f) ヒドロキノン	0. 0 3 <i>9</i>	7	400ワツトの50アンペア水銀灯(距離12イ
(g) ベンゾトリアゾール	0.129	[‡] 15	; ンチ)を用いて、30秒間高コントラスト透明膜
			を通して露光した。
(h) 染料	0.0 7 <i>9</i>		ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート)
(i) メチルエチルケトン	2 1 0.0 9	7	支持フイルムを引きはがし、露光したレジスト層
+ CD 2 4 0 Ctautama	_		を、少量の界面活性剤を含有する1%~1.5%の
* SR-349、Startome Industries 社のジエトキシ		20)苛性ソーダ水溶液とトレイ中で攪拌し現像する。
物の商標名	10100		提拌時間は、約1分である。提拌後水洗する。こ
			の現像法は、溶液Aにもまた溶液Bにも満足のい
容液 B			
容液 B			くものであつた。
		25	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ポードを20%の
(a) 75%スチレン、25%メタ クリル酸の共重合体;粘度	4 0. 0 <i>9</i>		くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ポードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漉し、水洗し
(a) 75%スチレン、25%メタ クリル酸の共重合体;粘度 (40%のメチルエチルケトン	4 0. 0 <i>9</i>		くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ポードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水で
(a) 75%スチレン、25%メタ クリル酸の共重合体;粘度 (40%のメチルエチルケトン 容液で測定)1000cps	4 0.0 <i>9</i>		くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ポードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漉し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漉し、水で すすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗
(a) 75%スチレン、25%メタ クリル酸の共重合体;粘度 (40%のメチルエチルケトン	4 0. 0 <i>9</i> 1 4. 0 <i>9</i>	1	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ポードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水で すすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗 浄されたポードを、55℃のピロリン酸銅メツキ
(a) 75%スチレン、25%メタ クリル酸の共重合体;粘度 (40%のメチルエチルケトン 溶液で測定)1000 cps (b) トリメチロールプロパントリ アクリレート		1	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漉し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漉し、水で すすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗 浄されたボードを、55℃のピロリン酸銅メッキ 浴中で、3.3アンペア/㎡(30アンペア/ft²)
 (a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体;粘度 (40%のメチルエチルケトン 溶液で測定)1000cps (b) トリメチロールプロパントリ 		i i 30	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ポードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水で すすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗 浄されたポードを、55℃のピロリン酸銅メツキ 俗中で、3.3アンペア/㎡(30アンペア/ft²) で45分間メツキした。両レジストともに下地銅
(a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体:粘度 (40%のメチルエチルケトン 密液で測定)1000cps (b) トリメチロールプロパントリアクリレート (c) テトラエチレングリコールジアクリレート	1 4.0 9	i i 30	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漉し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漉し、水で すすぎ、空気硫で乾燥して、洗浄される。この洗 浄されたボードを、55℃のピロリン酸銅メッキ 浴中で、3.3アンペア/π (30アンペア/ft²) で45分間メッキした。両レジストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メッキ浴の各成分から保護し
 (a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体;粘度 (40%のメチルエチルケトン 密液で測定)1000cps (b) トリメチロールプロペントリアクリレート (c) テトラエチレングリコールジアクリレート (d) トリエチレングリコールジア 	1 4.0 9	: 30	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水で すすぎ、空気硫で乾燥して、洗浄される。この洗 浄されたボードを、55℃のピロリン酸銅メツキ 俗中で、3.3アンペア/π(30アンペア/ft²) で45分間メツキした。両レジストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メッキ俗の各成分から保護し た。
(a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体:粘度 (40%のメチルエチルケトン 密液で測定)1000cps (b) トリメチロールプロパントリアクリレート (c) テトラエチレングリコールジアクリレート	1 4.0 9 7.0 9 1.0 2 9	; 30;	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水で すすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗 浄されたボードを、55℃のピロリン酸銅メツキ 谷中で、33アンペア/㎡(30アンペア/ft²) で45分間メツキした。両レンストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メッキ浴の各成分から保護し た。 2つの組成物間の主たる差異は、溶液Bが脆く
 (a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体;粘度 (40%のメチルエチルケトン 密液で測定)1000cps (b) トリメチロールプロペントリアクリレート (c) テトラエチレングリコールジアクリレート (d) トリエチレングリコールジア 	1 4.0	: 30:	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水で すすぎ、空気硫で乾燥して、洗浄される。この洗 浄されたボードを、55℃のピロリン酸銅メツキ 俗中で、3.3アンペア/㎡(30アンペア/ft²) で45分間メツキした。両レジストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メツキ俗の各成分から保護した。 2つの組成物間の主たる差異は、溶液Bが脆く 可撓性の悪いフイルム形成性高分子結合剤を用い
(a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体:粘度 (40%のメチルエチルケトン 密液で測定)1000cps (b) トリメチロールプロパントリアクリレート (c) テトラエチレングリコールジアクリレート (d) トリエチレングリコールジアセテート	1 4.0 9 7.0 9 1.0 2 9	300	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水で すすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗 浄されたボードを、55℃のピロリン酸銅メツキ 谷中で、33アンペア/㎡(30アンペア/ft²) で45分間メツキした。両レンストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メッキ浴の各成分から保護し た。 2つの組成物間の主たる差異は、溶液Bが脆く
 (a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体;粘度(40%のメチルエチルケトン密液で測定)1000cps (b) トリメチロールプロパントリアクリレート (c) テトラエチレングリコールジアクリレート (d) トリエチレングリコールジアセテート (e) トリクレジルフオスフェート (f) ペンソフェノン (g) 4・4'ーピスー(ジメチルア 	1 4.0 9 7.0 9 1.0 2 9 2.2 8 9 2.2 5 9	300	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水で すすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗 浄されたボードを、55℃のピロリン酸銅メツキ 谷中で、33アンペア/㎡(30アンペア/ft²) で45分間メツキした。両レジストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メツキ浴の各成分から保護し た。 2つの組成物間の主たる差異は、溶液Bが脆く 可撓性の悪いフイルム形成性高分子結合剤を用い でいるため形成した感光性レジストフイルムに十
 (a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体;粘度(40%のメチルエチルケトン密液で測定)1000cps (b) トリメチロールプロパントリアクリレート (c) テトラエチレングリコールジア・トリート (d) トリエチレングリコールジアセテート (e) トリクレジルフオスフェート (f) ベンソフェノン (g) 4・4′ーピスー(ジメチルアミノン 	1 4.0 9 7.0 9 1.0 2 9 2.2 8 9	300	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水で すすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗 静されたボードを、55℃のピロリン酸銅メッキ 浴中で、33アンペア/㎡(30アンペア/ft²) で45分間メッキした。両レジストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メッキ浴の各成分から保護した。 2つの組成物間の主たる差異は、溶液Bが脆く 可撓性の悪いフイルム形成性高分子結合剤を用い ているため形成した感光性レジストフイルムに十 分な可撓性を付与するために外部可塑剤(成分(c)
 (a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体;粘度 (40%のメチルエチルケトン 密液で測定)1000cps (b) トリメチロールプロパントリアクリレート (c) アテトシート (d) セチレングリコールジアセテート (e) トリクレジルフォスフェート (f) ペンプフェノン (g) 4・4'ーピステレンーピスー (h) 2・2'ーメチレンーピスー 	1 4.0 9 7.0 9 1.0 2 9 2.2 8 9 2.2 5 9 0.3 0 9	300	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水洗 すすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗 浄されたボードを、55℃のピロリン酸銅メツキ 浴中で、3.3アンペア/㎡(30アンペア/ft²) で45分間メツキした。両レンストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メツキ浴の各成分から保護した。 2つの組成物間の主たる差異は、溶液Bが脆く 可撓性の悪いフイルム形成性高分子結合剤を用い でいるため形成した感光性レンストフイルムに十 分な可撓性を付与するために外部可塑剤(成分(c) (d)溶液B)を加える必要があるのに対し、溶液A
 (a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体;粘度(40%のメチルエチルケトン密液で測定)1000cps (b) トリメチロールプロパントリアクリンート (c) アテトリングリコールジアトリート (d) セチレングリコールジアセテート (e) トリクレジルフォスフェート (f) ベンフェノン (g) 4・4ペーンソフェーレンイン (h) 2・2ペーメチレー・マイーエチルー6ーtert ープ 	1 4.0 9 7.0 9 1.0 2 9 2.2 8 9 2.2 5 9	300	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水た すすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗 浄されたボードを、55℃のピロリン酸銅メツキ 浴中で、33アンペア/m (30アンペア/ft²) で45分間メツキした。両レジストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メッキ浴の各成分から保護し た。 2つの組成物間の主たる差異は、溶液 Bが脆く 可撓性の悪いフイルム形成性高分子結合剤を用い ているため形成した感光性レジストフイルムに十 分な可撓性を付与するために外部可塑剤(成分(c) (d)溶液 B)を加える必要があるのに対し、溶液 A は、その共重合体が内部可塑性であり、よく改良
 (a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共産合体: 粘度 (40%のメチルケケン (40%のメチルケケン (40%のメチルア (100) 100) 100 1	1 4.0 9 7.0 9 1.0 2 9 2.2 8 9 2.2 5 9 0.3 0 9	300	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漉し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漉し、水で すすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗 静されたボードを、55℃のピロリン酸銅メッキ 浴中で、3.3アンペア/㎡(30アンペア/ft²) で45分間メッキした。両レジストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メッキ浴の各成分から保護した。 2つの組成物間の主たる差異は、溶液Bが脆く 可撓性の悪いフイルム形成性にジストフイルムに十 分な可撓性を付与するために外部可塑剤(成分(c) (d)溶液B)を加える必要があるのに対し、溶液 A は、その共重合体が内部可塑性であり、よく改良 されたフイルム形成材料である点である。この共
 (a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体;粘度(40%のメチルエチルケトン密液で測定)1000cps (b) トリメチロールプロパントリアクリンート (c) アテトリングリコールジアトリート (d) セチレングリコールジアセテート (e) トリクレジルフォスフェート (f) ベンフェノン (g) 4・4ペーンソフェーレンイン (h) 2・2ペーメチレー・マイーエチルー6ーtert ープ 	1 4.0 9 7.0 9 1.0 2 9 2.2 8 9 2.2 5 9 0.3 0 9	300	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水洗 すすぎれたボードを、55℃のピロリン酸銅メツキ 浴中で、33アンペア/m(30アンペア/ft²) で45分間メッキした。両レンストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メッキ浴の各成分から保護した。 2つの組成物間の主たる差異は、溶液Bが脆く 可撓性の悪いフイルム形成性レンストフイルムに十 分な可撓性を付与するために外部可塑剤(成分(c) (d)溶液B)を加える必要があるのに対し、溶液A は、その共重合体が内部可塑性であり、よく改良 されたフイルム形成材料である点である。この共 重合体は、乾燥寛容度、保全性(フイルム粘着性)
 (a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共産合体: 粘度 (40%のメチルケケン (40%のメチルケケン (40%のメチルア (100) 100) 100 1	1 4.0 9 7.0 9 1.0 2 9 2.2 8 9 2.2 5 9 0.3 0 9	300	くものであつた。 露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の 過硫酸アンモニウム俗に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水洗し さらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水洗 静されたボードを、55℃のピロリン酸銅メッキ 浴中で、33アンペア/m(30アンペア/ft²) で45分間メッキした。両レジストともに下地銅 表面をピロリン酸銅メッキ浴の各成分から保護した。 2つの組成物間の主たる差異は、溶液Bが脆く 可撓性の悪いフイルム形成性ロジストフイルムに十 分な可撓性を付与するために外部可塑剤(成分に) (d)溶液B)を加える必要があるのに対し、溶液 A は、その共重合体が内部可塑性であり、よくの されたフイルム形成材料である。この共 されたフィルム形成材料である。この共 されたフィルム形成材料である。この共 重合体は、乾燥寛容度、保全性(フィルム粘着性) および静的負荷下のコールドフローまたはクリー

サンドイッチ構造の帯状物からポリエチレンシー

トを除去し、ポール中につめ込みそれを取り出し 引き伸ばす前述の試験法によつて測定された。

可撓性試験はまた強制対流炉中で10分間 1 8 0 F で乾燥した溶液 A、 B からなるフイルム にも実施された。この試験法は、光重合性レジス 5 性成分が結合剤重合体の骨格の1部をなしている トフイルムの乾燥寛容度を決定するためのもので ある。良好な乾燥寛容度であることは、商業用レ ジストフイルムにとつて必要不可欠のことである。 というのは、かかるレジストから作つた製品は、 その可撓性が残存溶媒に影響されず、良好な貯蔵 10 繰フオトレジストフイルムは、2週間で著しいコ 寿命を有するからである。

次の表は、溶液A、Bから形成した2つのフィ ルムが可撓性、表面粘着性、乾燥寛容度の点で重 大な差異があることを示す。

麦 A

	通常	の乾燥	特別の乾燥後		
組成	可撓性	表面粘着性	可撓性	表面粘着性	
榕液 A	良好	低い	良 好	低い	
溶液B	やや良	少し粘着	貧 弱	低い	

コールドフローまたは塑性クリープは乾燥レジ ストフイルムにとつて重要な問題である。乾燥し 25 たレジストフイルムは種々の長さおよび幅のロー ル巻きで販売されている。これらのロール巻きに はある程度の張力が掛けられる。それは層間の左 重ねまたはすべりを減殺するためのものである。 ところがこの張力が塑性クリープを誘発する。コ 30 これは溶液 Aのフイルムでは端ににじみ出しがほ ールドフローの影響は、端の融解または連続層の 端の融着である。この融着のためポリエステル基 体から光重合性層を少し取り除かなくてはロール 巻きを解くことができないし、また乾燥フイルム にピンホールや大きな不連続部を形成することに 35 より厚さ約1ミルになるまで乾燥し、ポリエチレ なる。こうした現象の生じたレジストは、その剝 離部に露光による重合が起らず、またプリント回 路導体の切断がピンホール部で起り、消費者にと つて受容し難い欠点である。

コールドフローは、水溶液から形成する公知の 40 乾燥レジストフイルムにおいて特に顕著である。 その典型的な例が溶液 B組成物である。その原因 は、結合剤樹脂が連鎖セグメントを含有するカル ポン酸の大きな割合(普通20~25%)を含む

ことである。 これらのセグメントは、フイルムを 脆くする。このフイルムは外部可塑剤により可撓 性のあるものにされるが、一面表面粘着性が増す と共にひどいクリープ性に繋がる。榕液Aは可型 のでかかる欠点を生じない。

前述のコールドフロー試験法を用いて、巻き上 げ乾燥フイルムロールを貯蔵し実験した。 この条 件下では、溶液B組成物からなる厚さ2ミルの乾 ールドフローを示し、その巻きロールは1ヶ月の 貯蔵で販売出来ないものになつた。他方、溶液 A の塗布液から作られたフイルムは端の融解がなく また7ケ月の貯蔵によつても内部ピンホールの形 15 成がなかつた。

スウオード便度テストを用いた結果を次に示す。

R スウォード便度

組成	1ミルフイルム	2ミルフイルム
溶液A	16~18	10~12
容液B	8~10	4~6

実験フイルムの写真を、既知の受容しうるコー ルドフロー特性を有するレジストフイルムの写真 と比較した。溶液Aのフイルムは、溶液Bのフイ ルムに較べきわめて少ないワイヤ目盛を示した。 とんどないことを示す。

実施例 2

20

次の組成物を作り、厚さ1ミルのポリエステル フイルムの上に塗布し、実施例1で記した方法に ンで被覆する。

容液C

(a) 50%スチレン、20%メチ ルメタクリレート10%エチル アクリレート、20%メタクリ ル酸の共重合体;粘度(40% メチルエチルケトン溶液で側定) 4 5 0 0 cps

4 0.0

17

(b) トリメチロールプロパントリ アクリレート	1 3.3 3 %	も 優 れていた。 実施例 3
(c) テトラエチレングリコールジ アクリレート	6. 6 7 <i>8</i>	次の組成物を作り、ポリエステルフイルムの上 に厚さ1ミルに塗布し、実施例1で述べた方法で

2.2 58 5 厚さ約1ミルまで乾燥し、ポリエチレンで被覆し (d) ペンゾフエノン た。

4・4'ーピスー(ジメチルア 0.308 容液D ミノ)ーペンプフエノン

(f) 2·2ーメチレンーピスー (4-エチルー6- ters -プ 0.308 チルフエノール

(g) ベンゾトリアゾール 0.108

(h) 染料 0.078

210.0 8 (i) メチルエチルケトン

銅被覆エポキシフアイバーグラスボードを洗浄 し、上述の組成物で積層する。対象ポードは、実 施例1の密液Bの組成物で作られたフイルムを積 届したものである。各ポード共に実施例1で述べ た方法により露光し、現像し、ピロリン酸銅浴中 20 でメツキした。両レジストフイルム共に、加熱ア ルカリメツキ俗中ですばらしいメツキが行なわれ

実施例2では新規なレジストフイルムの物理的 性質が単量体成分によつてどう変わるかを示す。 25 (h) ベンゾトリアゾール 容液Cはエトキシル化ビスフエノールーAジアク リレート(容液A)の代わりにトリメチロールプ ロパントリアクリレートを用いる。この変換は、 光重合性レジストフイルムの可撓性および乾燥寛 容度にほとんど影響を及ぼさない。しかしながら 30 スウォード便度の点で表Cに示すように減殺して いる。

C 表 スウォード硬度

組成	1ミルフイルム	2ミルフイルム
容液A	16~18	10~12
容液C	1 2 ~ 1 4	8~10

溶液Cの組成物から作られたロール巻きは、2 ミルの厚さに墜布されたものであり、実施例1の 方法によつてコールドフローがテストされた。そ の挙動は、溶液Bの組成物から作られたものより

(a) 40%スチレン、5%メチル メタクリレート 25%エチルア クリレート、30%メタクリル 10 4 0.0 8 酸の共重合体;粘度(40%メ チルエチルケトン溶液で測定) 5 8 0 0 cps

(b) トリメチロールプロパントリ 1 4.0 8 アクリレート 15

(c) テトラエチレングリコールジ 7.0 8 アクリレート

(d) ベンゾフエノン 1.508

(e) 4・4'-ピスー(ジメチルア 0.208 ミノ) ーペンプフエノン

(f) 2·2'-メチレンーピスー (4-エチルー6-tert -プ 0.308 チルフエノール)

(g) トリルトリアゾール 0.049

0.128

(i) 染料 0.068

(j) メチルエチルケトン 2 1 0.0 %

1 0. 5 % メチルセロソルブ

銅被覆エポキシフアイバーグラスポードを洗浄 し、上記のフイルムで積層し、実施例1の方法で 露光した。フイルムの露光しない部分を、1.5% 炭酸ナトリウム水溶液含有トレイ中で30~60 35 秒攪拌して洗い流した。得られたポードを塩化第 二鉄の45° ポーメ榕液でエツチングし、洗い、 乾燥した。レジストを130Fの3%苛性ソーダ 液に2分浸漬して除去した。得られたポードは、 良質のプリント回路ポードであつた。1ミルの感 40 光性フイルムの可撓性と乾燥寛容度は良好であり

スウオード硬度は12~14であつた。

銅破覆エポキシフアイバーグラスポードを実施 例1のように洗浄し、乾燥した。このポードに次

の溶液のレジスト フイルムを 1ミルの厚さで赭層 した。

容液E

(a) 47.5%スチレン、20%メ チルメタクリレート、10%ア クリロニトリル、22.5%メタ クリル酸の共重合体;粘度 (38%メチルエチルケトン容 液で測定) 3 7 0 0 cps

40.0 8

7.0 8

2.2 5 8

0.308

0.15 🗲

0.078

- (b) トリメチロールプロパントリ アクリレート
- (c) テトラエチレングリコールジ アクリレート
- (d) ペンプフエノン
- (e) 4 · 4'ービスー(ジメチルア ミノ)ーペンゾフエノン
- (f) 2・2'ーメチレン ービスー (4ーエチルー6ー tert ープ チルフェノール)
- (g) ペンゾトリアゾール
- (山) 染料
- (i) メチルエチルケトン

2 1 0.0 %

横層ポーベル実施例 1 記載の化学的活性放射線 %のリン酸ナトリウムと少量の界面活性剤を含む 水溶液とポードとをトレイ中で1分攪拌し除去す る。

1ミルの光感受性フイルムの可撓性と乾燥寛容 度は良好であり、絶縁塗料の表面は粘着性がなく 30 実施例 8 スウオード硬度は16~18であつた。

上記の2%リン酸三ナトリウムで現像したボー ドを更に実施例1のように洗浄し、55℃のピロ リン酸銅メッキ俗中で 45分、33アンペアノデ 結果が得られた。

実施例 5

実施例1の光重合性溶液Aを、亜鉛、マグネン ウム、銅の各プリント板に被覆した。約1ミルの 厚になるまで暖風で乾燥し、次いでポリピニルア 40 ルコールの稀薄溶液を塗布し、乾燥した。水可溶 性重合体は酸素に対する薄い保護膜を形成した。 これらの反応し易い金属板は相当の間貯蔵可能と なつた。

20

化学的活性灯に適当なネガを介して露光し、未 露 光感光性層と水熔性トップ コートを同時に現像 し、エッチング用金属板に仕上げた。光重合した 像は金属プリント板の製造に通常用いられる強い 5 エッチング工程に対してもすばらしい耐性を示し た。これらのレジストは、通常のエッチング剤 即ち塩化第二鉄、硝酸、フィルム形成剤およびエ ツチングの形状をコントロールするため通常に忝 加されるパンキング剤によい耐性を示した。

14.0 8 10 実施例 6

実施例5において水可溶性重合体の代わりに保 護層として1ミルのポリエステルフイルムを用い た以外は同様の実施を行なつた。化学的活性灯に 露光した後、アルカリ水溶液で現像する前に保護 0.309 15 層を除去した。実施例5のように光重合した像は プリント板の強いエツチングに対して著しい耐性 を示した。

実施例 7

実施例1の溶液Aをポリエステルフイルムに1 20 ミルの厚さで塗布し空気で乾燥し、1ミル厚さの ポリエチレンフイルムで覆つた。これらのサンド イツチ三層構造のフイルムは、シートないしはロ ールの状態で、ほとんど変化なく長時間貯蔵でき た。使用に先立ちポリエチレンカパーフィルムを を照射する。レジストフイルムの未露光部を、2 25 取り除き、感光層を実施例 5 の金属プレートに接 合し、積層する。化学的活性灯に露光し、保護ポ リエステル層を取り除き、アルカリ溶液中で現像 する。実施例5のように光重合像はプリント板の. 強いエツチングに対しすばらしい耐性を示した。

実施例1の溶液Aを、実施例5、6、7に記し たようにオフセツト石版印刷の常法に従つて薄い アルミニウム板上に被覆する。化学的活性灯の露 光、アルカリ溶液による現像を行なつた。光重合 (30 アンペア/ft²)でメッキした。すばらしい 35 像は、インク受容体としてすばらしいものであっ た。またすばらしい摩擦抵抗をも示した。この実 施例のプレートは、オフセツト石版印刷に良好な 結果をもつて使用された。

実施例 9

実施例1の溶液Aは、実施例5、6、7に示し たように積布、メツシユ様基体の上に塗布された。 化学的活性灯への露光、アルカリ水溶液による現 像を行なつた。光重合像は、すばらしいマスクを 示した。この応用は、絹のスクリーンブリントに

21

も有効である。

以下に本発明の実施態様を記す。

- 1.(A) 実質的に1ないしそれ以上の100℃以上 の沸点を有する非ガス状化合物の実質的に1 種またはそれ以上の附加重合性物質10~ 5 60重量部
- (B) 光によりフリーラジカルを発生する附加重 合開始剤系、および
- (C) 40~90重量部のあらかじめ形成された 巨大分子の高分子結合剤であつて、その重合 10 体は、一般式

$$R-C=CH_2$$

(式中Rは水素、炭素数1~6のアルキル基またはハロゲンである)

で表わされる群から選ばれた1またはそれ以 20 上のスチレン型化合物またはそれらの環置換 誘導体を含有する第1単量体物量と、

1またはそれ以上のアルキルアクリレート、アルキルメタクリレート、ヒドロキシアルキルアクリレートまたはヒドロキシアルキルメ 25 タクリレートの群から選ばれ、アルキル基は炭素数1~6、ヒドロキジアルキル基は炭素原子数2~6である化合物を含有する第2の単量体と、

1種またはそれ以上の炭素数3~15のα·30 βー不飽和カルポキシル基含有単量体を含有 する第3の単量体物質

からなり、各単量体物質の割合は、結合剤を稀 薄アルカリ水溶液に可溶性にする割合であり、 しかも光重合性組成物が外部可塑剤の添加なし 35 で可撓性を保持できる割合である事を特徴とす る光重合性組成物。

- 2. 第1単量体物質がスチレンである第1項記載 の光重合性組成物。
- 3. 第2単量体物質がメチルメタクリレートまた 40 はエチルアクリレートまたはそれらの混合物で ある第1項記載の光重合性組成物。
- 4. 第3単量体物質がメタクリル酸である第1項 記載の光重合性組成物。

22

- 5. 付加重合性物質が1またはそれ以上のポリオールの不飽和エステルである第1項記載の光重合性組成物。
- 6. 付加重合性物質がトリメチロールプロパン、 トリアクリレートおよびテトラエチレングリコ ールジアクリレートである第1項記載の光重合 性組成物。
 - 7. 付加重合性物質がジエトキシル化ビスフエノールAジアクリレートおよびテトラエチレングリコールジアクリレートである第1項記載の光重合性組成物。
 - 8. 次の各構成からなる積層体:
 - (A) 頻または銅合金からなる金属基体

 - (C) 酸素不透過性の被覆層。
 - 9.(A) 沸点100℃以上の非ガス状付加重合可能な物質:フリーラジカルを発生する付加重合開始削系、共重合体の第1単量体がスチレート型物質であり、第2単量体がアクリレート子の数であり、そして第3単量体が炭素原含有量体が炭素の不飽和カルポキシル基含有単量体に対する単なしで付与され、かつ前記各単量体から可容性にする割合である、光重合可能な層を製造してする割合である、光重合可能な層を製造してする割合である、光重合可能な層を製造した。
 - (B) 前記の光重合可能な層を化学的活性光線に 露光し、そして
 - (C) 稀薄アルカリ水溶液で前記層を洗浄し、光 重合可能な層の未露光部を除去する 事より成る事を特徴とするフォトレジストの製

造法。

- 10. 光重合可能な層を基体に塗布し、光重合性層 の未露光部分で被覆された基体の部分を洗浄に より剝離することからなる第9項記載の方法。
- 11. 光重合性層を前記の洗浄を完了した後に、前 5 記基体の非被覆部を永久的に変性するために光 重合可能な層を処理する第 1 0 項記載の方法。
- 12(A) 1またはそれ以上のポリオールの不飽和エステルであつて、その沸点が100℃以上のもの10~60重量部の付加重合性物質。
 - (B) 光開始でフリーラジカルを発生する付加重

24

合開始剤系、および

- (C) 共重合体成分がスチレン、メチルメタクリレート、エチルアクリレートおよびメタクリル酸であつて、その単量体割合が、結合剤を稀薄アルカリ水溶液に可溶性にし、かつ外部可塑剤なしで結合剤に可撓性が付与される割合である共重合体の40~90重量部のあらかじめ形成された巨大分子の高分子結合剤から成ることを特徴とする光重合性重合体。
- 10 13. 第 1 ~ 8 項記載の光重合性組成物を化学的活 性線に露光することによつて得られる製品。